

低挥发导热泥

TM200-L是一款导热系数2.0W/(m·K)，单组份低挥发导热泥，可塑性很强，应用工艺可根据客户的需求制作成高压缩率的片状产品或制作半流动状态满足自动点胶工艺，具有高效的导热效果和优异的填缝效果，主要应用于低压力和对硅挥发有需求的场合。

特性和优点

- 导热系数：2.0W/(m·K)
- 低挥发
- 极低的界面热阻
- 低安装应力
- 常温储存

典型应用

- 安防设备
- 光模块等光学应用
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元

典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
密度(g/cc)	2.8	ASTM D792
挤出率(g/s)	>6	ISO9048
低分子硅氧烷含量D3~D10(ppm)	<50	ASTM F2466-10
耐温范围(°C)	-60~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期 (月)	6	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>5.0	ASTM D149
体积电阻率(Ω·cm)	10^{12}	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/m·K)	2.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W @50psi,0.3mm)	<0.56	ASTM D5470